

证券代码：873294 证券简称：创达新材 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡创达新材料股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”），为本次发行上市之需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司制定了本次发行上市方案，主要内容如下：

(1) 本次发行股票的种类：

人民币普通股。

(2) 发行股票面值：

每股面值为 1 元。

(3) 本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 12,329,345 股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行初始发行股票数量的 15%（即不超过 1,849,401 股，含本数），若考虑全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下，公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 14,178,746 股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量以北京证券交易所核准并经中国证监会注册的数量为准。

(4) 定价方式：

通过 发行人和主承销商自主协商直接定价 合格投资者网上竞价

√网下询价方式确定发行价格。

(5) 发行底价：

发行底价为后续的询价或定价结果。

(6) 发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

公司本次发行股票募集资金计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	年产 12000 吨半导体封装用关键配套材料生产线建设项目	23,600.00	20,000.00
2	研发中心建设项目	3,700.00	3,700.00
3	补充流动资金	6,300.00	6,300.00
合计		33,600.00	30,000.00

如本次发行的实际募集资金量少于上述项目投资需求，发行人将通过自筹方式解决。本次发行募集资金到位之前，若发行人已根据项目进度实际情况以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。

(8) 本次发行前滚存利润的分配方案：若公司本次发行申请获得批准并成功发行，本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行后的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

(9) 发行完成后股票上市的相关安排：本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。并遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》关于锁定期的要求。

(10) 决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。若股东大会决议有效期内公司本次发行上市通过北京证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的决定，则该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。

(11) 其他事项说明（如适用）

发行方式：本次发行全部采取发行新股方式，不包括现有股东转让股份。

承销方式：余额包销。

战略配售：本次发行上市战略配售的具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会与主承销商届时根据法律、法规、规章和规范性文件的规定以及市场状况确定。

本次发行上市方案需通过公司股东大会的审议，并获得与会股东所持表决权三分之二以上通过，报北京证券交易所审核同意，并报中国证监会履行发行注册程序后方可实行，并最终以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的最近两年财务报表及审计报告，公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据)分别为 4,624.67 万元、5,877.95 万元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据)分别为 9.55%、11.14%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

三、 备查文件目录

《无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

无锡创达新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日